



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20051117000D
2011 年 3 月 15 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタムドキュメント
マネージャ 牧 達郎 

ASP-MCU MSP430 一部製品 前処理サイト追加のご案内
(認定済 126 製品への追加認定 46 製品の連絡)

(第二版 PCN20051117000A 2006 年 3 月 28 日発行, 初版 PCN20051117000 2005 年 12 月 21 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての追加連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではありません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはありません。

変更品の出荷につきましては、本通知発行日より **90** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。本変更に対するお客様個別のご要求に関しましては、個別契約にて承ります。弊社と合意済みの個別要求につきましては、別途対応させていただきます。担当営業にご確認下さい。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)		☒ Final notice	
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	☒ Wafer Fab	☒ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Assembly	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling	☐	-
変更内容	下記変更について認定済126製品への追加認定46製品の連絡になります。 ASP-MCU MSP430 一部製品 前処理サイト追加 現行 : 認定量産サイト 変更後: 認定量産サイト、TSMC-F11社(WAFERTECH, 米国)			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	追加認定品は7月上旬の出荷より予定しています。 認定終了品は2006年7月中旬の出荷より実施しています。			
品質認定試験	☐ 計画		☒ 終了	
製品表示	☐ 変更無し		☒ 変更あり	
備考	-			

変更内容

内容: 今回のお知らせは、下記変更について認定済126製品への追加認定46製品の連絡になります。弊社 ASP-MCU(マイクロコントローラ) MSP430 一部製品のの前処理サイトについて、供給能力向上の為に、TSMC-F11社(WAFERTECH, 米国)サイトでの製造を追加し認定しました。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
前処理サイト	認定量産サイト	認定量産サイト TSMC-F11社(WAFERTECH, 米国)

理由: 供給能力向上の為

対象製品リスト

対象製品名				
■: 追加認定品 □: 認定終了品				
MSP430A044IPM	MSP430F135IPM	MSP430F149IPMRG4	MSP430F2002TPWR	MSP430G2231IN14
MSP430F1101AIDGV	MSP430F135IPMR	MSP430F1491RTDR	MSP430F2002TRSAR	MSP430G2231IPW14
MSP430F1101AIDGVR	MSP430F1351RTDR	MSP430F1491RTDT	MSP430F2002TRSAT	MSP430G2231IPW14R
MSP430F1101AIDW	MSP430F1351RTDT	MSP430F149CY	MSP430F2012CY	MSP430G2231IRSA16R
MSP430F1101AIDWR	MSP430F1471IPAG	MSP430F149CYS	MSP430F2012IN	MSP430G2231IRSA16T
MSP430F1101AIPW	MSP430F1471IPAGR	MSP430F149IPAG	MSP430F2012IPW	MSP430V102IPM
MSP430F1101AIPWR	MSP430F1471IPM	MSP430F149IPAGR	MSP430F2012IPWR	MSP430V103IPMR
MSP430F1101AIRGER	MSP430F1471IPMR	MSP430F149IPM	MSP430F2012IRSAR	MSP430V1061RTDR
MSP430F1101AIRGET	MSP430F1471RTDR	MSP430F149IPMG4	MSP430F2012IRSAT	MSP430V1061RTDRG4
MSP430F1111AIDGV	MSP430F1471RTDT	MSP430F149IPMR	MSP430F2012TN	MSP430V107IPM
MSP430F1111AIDGVR	MSP430F147IPAG	MSP430F149IPMRG4	MSP430F2012TPW	MSP430V1121RHAR
MSP430F1111AIDW	MSP430F147IPAGR	MSP430F1491RTDR	MSP430F2012TPWR	MSP430V1141PM
MSP430F1111AIDWR	MSP430F147IPM	MSP430F1491RTDT	MSP430F2012TRSAR	MSP430V116AIDGVR
MSP430F1111AIPW	MSP430F147IPMR	MSP430F155IPM	MSP430F2012TRSAT	MSP430V117AIPWP
MSP430F1111AIPWR	MSP430F147IPMRG4	MSP430F155IPMR	MSP430FG437IPN	MSP430V1181PM
MSP430F1111AIRGER	MSP430F1471RTDR	MSP430F156IPM	MSP430FG437IPNR	MSP430V1181PMR
MSP430F1111AIRGET	MSP430F1471RTDT	MSP430F156IPMR	MSP430FG438IPN	MSP430V1191RTDR
MSP430F1121ACY	MSP430F1481IPAG	MSP430F157IPM	MSP430FG438IPNR	MSP430V1201RTDR
MSP430F1121ACYS	MSP430F1481IPAGR	MSP430F157IPMR	MSP430FG439IPN	MSP430V1211RHAR
MSP430F1121AIDGV	MSP430F1481IPM	MSP430F167IPM	MSP430FG439IPNR	MSP430V1221PMR
MSP430F1121AIDGVR	MSP430F1481IPMR	MSP430F167IPMR	MSP430G2121IN14	MSP430V1231PMR

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

MSP430F1121A1DW	MSP430F14811RTDR	MSP430F1681PM	MSP430G21211PW14	MSP430V1261RHAR
MSP430F1121A1DWR	MSP430F14811RTDRG4	MSP430F1681PMR	MSP430G21211PW14R	MSP430V1271PMR
MSP430F1121A1PW	MSP430F14811RTDT	MSP430F169CY	MSP430G21211RSA16R	MSP430V1311PAGR
MSP430F1121A1PWR	MSP430F1481PAG	MSP430F169CY	MSP430G21211RSA16T	MSP430V1321RHAR
MSP430F1121A1RGER	MSP430F1481PAGR	MSP430F169CYS	MSP430G21311N14	MSP430V1321RHARG4
MSP430F1121A1RGET	MSP430F1481PM	MSP430F1691PM	MSP430G21311PW14	MSP430V1351PNR
MSP430F1331PAG	MSP430F1481PMG4	MSP430F1691PMR	MSP430G21311PW14R	MSP430V1481N
MSP430F1331PAGR	MSP430F1481PMR	MSP430F20021N	MSP430G21311RSA16R	MSP430V2141PWR
MSP430F1331PM	MSP430F1481RTDR	MSP430F20021PW	MSP430G21311RSA16T	MSP430V2241PWR
MSP430F1331PMR	MSP430F1481RTDT	MSP430F20021PWR	MSP430G22211N14	MSP430V2331PWR
MSP430F1331RTDR	MSP430F14911PAG	MSP430F20021RSAR	MSP430G22211PW14	MSP430V2551PWR
MSP430F1331RTDT	MSP430F14911PAGR	MSP430F20021RSAT	MSP430G22211PW14R	
MSP430F1351PAG	MSP430F14911PM	MSP430F20021TN	MSP430G22211RSA16R	
MSP430F1351PAGR	MSP430F14911PMR	MSP430F20021TPW	MSP430G22211RSA16T	

製品表示

この変更に伴い、製品捺印上に、前処理サイトが明記され、LOT コードにてトレーサビリティを持っています。

信頼性試験

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	2005 年 9 月 27 日	終了	2006 年 5 月 30 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qualification Device:	MSP430F1491PM	Fab Process:	0.35u 2P4M	
Wafer Fab Site:	WAFER TECH	Fab Technology:	TSMC 0.35u	
Passivation:	1uHDP-Ox 0.7u SiN 5uPoly	Die Overcoat:	Polymide	
Metal 1-3:	AlCu0.5%	-	-	
Assembly Site:	TI Taiwan, Taipei	Package Code/Pins:	PM/64	
Mount Compound:	HIT EN-4085S2K3	Mold Compound:	HIT CEL9200HF13	
Bond Wire:	TS-1.0 Au	Lead Frame(Finish,Base):	NiPdAu, Cu	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot1	Lot2	Lot3
**Biased Operating Life	150C, 300hrs	120/0	120/0	120/0
**Biased HAST	130C/85%RH, 98hrs	80/0	80/0	80/0
**Autoclave	121C, 240hrs	80/0	80/0	80/0
**Thermal Shock	-65/150C, 1000hrs	80/0	80/0	80/0
**ESD HBM	500, 1000, 1500, 2000 V	3/0	3/0	3/0
**ESD MM	50, 100, 150, 200 V	3/0	3/0	3/0
**ESD CDM	100, 500, 750 V	3/0	3/0	3/0
Electrical Characterization	Across Temp/Voltage, per DS spec	Approved	Approved	Approved
Latch-Up	150mA Current Injection, 25C	6/0	6/0	6/0
**Storage Life	170C, 420HRS	80/0	80/0	80/0
Write/ Erase Endurance, Data Retention and Data Gain	-40/25/85C, min.20K W/E cycle	12/0	12/0	12/0
Moisture Sensitivity	JEDEC L-3/260C	12/0	12/0	12/0
Manufacturability (Assembly)	Per applicable A/T spec	Approved	Approved	Approved
Manufacturability (Wafer Fab)	Per Fab Spec	Approved	Approved	Approved
Wafer Level Reliability	Per Fab Spec	Approved	Approved	Approved
Note: ** Preconditioning required, JEDEC L-3/260C				